



2020年3月5日

各 位

会 社 名 株式会社テラプローブ  
代 表 者 代表執行役社長 浦崎 直彦  
(コード番号：6627 東証マザーズ)  
問合せ先 Vice President 地主 尚和  
(TEL 045-476-5711)

## 当社子会社による子会社（孫会社）の設立に関するお知らせ

当社の連結子会社であるTeraPower Technology Inc. は、本日開催の取締役会において、中華人民共和国（以下「中国」といいます。）に子会社（当社の孫会社、以下「新会社」といいます。）を設立することを決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新会社設立の背景及び目的

半導体市場は、中長期的な成長が期待されていますが、特に中国においては、半導体産業の育成が国家的なプロジェクトとなっており、かつ、従来のファブレスメーカーや前工程工場を育成する方針から、後工程も含めた全工程のサプライチェーンを構築する方針に変化するなど、半導体テスト受託を主たる業務とする当社グループにとって、ビジネスを獲得する機会が拡大しています。

当社グループは、このような機会を捉え、ビジネスを獲得するため、ウエハテスト及びファイナルテストを受託する新会社を中国 蘇州に設立することといたしました。

当社の親会社であるPowertech Technology Inc.（以下「PTI」といいます。）は、後工程の受託を主たる業務とし、中国 蘇州にも拠点を有しており、新会社とPTI及びそのグループ会社が連携することで、ウエハテスト以降を一貫して請け負うターンキーサービスの提供が可能となります。

現在、経済活動に対する新型コロナウイルスの影響が懸念されておりますが、上記のとおり、中長期的には、市場の成長とビジネス機会が期待されること、また中国での事業開始に際しては、台湾及び中国における許認可等の取得に一定の時間を要することなどから、新会社の設立を決定し、状況改善後の速やかな事業活動を可能とする環境を整えることといたしました。量産開始は、最短で2020年第4四半期（10月～12月）を目指しておりますが、事業活動の開始に際しては、新型コロナウイルスの影響や経済環境も考慮しつつ判断してまいります。

## 2. 子会社の概要

(1)名 称	TeraPower Technology Inc.
(2)所 在 地	No. 20, Wenhua Rd., Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu 303, Taiwan
(3)代表者の役職・氏名	董事長 洪 嘉諭
(4)主 な 事 業 内 容	半導体ウエハテスト、ファイナルテスト受託
(5)資 本 金	NT\$ 1,497,670,000
(6)設 立 年 月 日	2008年8月7日
(7)出 資 比 率	株式会社テラプローブ 51% Powertech Technology Inc. 49%
(8)当社と当該会社との関係等	当社の連結子会社となります。

## 3. 新会社の概要

(1)名 称	晶兆成半導體(蘇州)有限公司 (予定)
(2)所 在 地	No. 33 Xinghai Street, Suzhou, 215021, People's Republic of China
(3)代表者の役職・氏名	董事長 林 育全
(4)主 な 事 業 内 容	半導体ウエハテスト、ファイナルテスト受託
(5)資 本 金	US\$ 10,000,000 (予定)
(6)設 立 年 月 日	台湾及び中国における必要な許認可取得後確定
(7)出 資 比 率	TeraPower Technology Inc. 100%
(8)当社と当該会社との関係等	当社の連結子会社となります。

## 4. 今後の見通し

今期の当社業績に与える影響につきましては、軽微であります。今後、開示の必要性が生じた際は、速やかにその内容を開示いたします。

以 上